关于新时期促进集成电路产业高质量发展的

若干政策申报指南

（2022年版）

1. 申报对象

工商注册、税务关系及统计关系均在东湖高新区内，主营业务为集成电路设计、制造、封装、测试、设备、材料以及提供集成电路产业公共技术（服务）的企业和社会团体，且在政策支持期间在东湖高新区内持续经营、依法纳税、具有独立法人资格。

重点支持方向：

1. 存储芯片及其相关模块、控制器芯片、5G及通信芯片、新型显示芯片、红外探测芯片、LED驱动芯片、北斗芯片等产品。
2. 微控制器（含RISC-V架构）、功率半导体、模拟及数模混合电路、微机电系统（MEMS）、射频电路、先进封装、半导体高端设备、大尺寸硅片、EDA、异构计算芯片、化合物半导体等技术。
3. 申报时间

自通知发布之日起受理申报，申报截至时间为**2023年4月28日**。

支持周期即为后文所称“年度”，起止时间为：**2022年1月1日-2022年12月31日**（本政策属于后奖补政策，奖补依据为企业在支持周期内实际发生的费用）。

1. 申报类别
2. **支持人才集聚**
3. **支持方式**
4. 对经认定的新招聘的集成电路相关专业人才给予安家补助，补助标准为硕士或副高职称每人9万元，博士或正高职称每人15万元，分三年度等比例拨付。
5. 对集成电路企业高级管理人员和技术研发人员，工资薪金部分应纳税所得额超过30万元至50万元的，给予每人每年2万元薪酬补贴；工资薪金部分应纳税所得额超过50万元至80万元的，给予每人每年5万元薪酬补贴；工资薪金部分应纳税所得额超过80万元的，给予每人每年8万元薪酬补贴。年度工资薪金应纳税
6. 同一企业每年高级管理人员补贴人数不得超过3人。
7. 同一人员在东湖高新区内仅能享受一次安家补助。同一支持周期内，安家补助和薪酬补贴不可同时享受。
8. 已获得“3551光谷人才计划”一事一议和重点企业高端人才等政策支持的集成电路人员，不再享受本政策。
9. 同一企业每年安家补助及薪酬补贴合计最高不超过500万元。
10. **申报条件**
11. 新招聘的集成电路相关专业的人才应在东湖高新区首次就业并与企业签订劳动合同，且在东湖高新区缴纳社会保险金和个人所得税均在半年以上。高级（正、副）职称应为政府职能部门颁发的集成电路相关专业职称证书。
12. 集成电路企业高级管理人员（限额）和技术研发人员应与单位签订2年以上劳动合同，且在东湖高新区缴纳社会保险和个人所得税满一年。高级管理人员应在企业管理层中担任重要职务、负责公司经营管理，技术研发人员应在企业从事技术研发工作。
13. **支持企业集聚**
14. **支持方式**
15. 研发类企业在东湖高新区租赁研发或生产用房，企业成立未满2年的给予房租全额补贴，企业成立2年以上未满5年的，给予房租50%补贴，每年补贴面积最高不超过1000平米，补贴金额最高不超过200万元。
16. 生产类企业在东湖高新区租赁研发和生产用房，企业成立未满2年的给予房租全额补贴，企业成立2年以上未满5年的，给予房租50%补贴，每年补贴面积最高不超过3000平方米，补贴金额最高不超过500万元。
17. 企业在东湖高新区购置研发或生产用房，按照实付金额的10%给予补贴。如人均面积超过20平方米，则以期末社保在册人数为基准，按照人均20平方米计算补贴面积，依据补贴面积所对应购置价款的10%给予补贴，下一支持周期以期末社保在册增量人数为基准核算，同一企业累计补贴不超过500万元。
18. 对涉及多项集成电路业务的企业，根据年营业收入占比最高项业务确定其申报奖励的类别。
19. **申报条件**
20. 支持周期内企业注册时间未满五年，企业在东湖高新区租用自用研发或生产用房，未出（转）租，未改变用途。
21. 企业在东湖高新区购置自用研发或生产用房，未出（转）租或出售，未改变用途。
22. 企业租用或购置非关联方的房产。
23. **支持购买设计工具**
24. **支持方式**
25. 按照购买IP、EDA实际支出费用的20%，给予同一企业每年最高不超过200万元补贴。
26. 按照EDA研发费用加计扣除部分的50%，给予同一企业每年最高不超过3000万元补贴。
27. **申报条件**
28. 企业直接购买集成电路IP（知识产权）、EDA（电子设计自动化）并用于研发。
29. 企业购买IP（不包含委托技术服务）的，应为授权协议中IP最终被许可方。
30. 企业购买EDA的，应与主流EDA供应商签订最终用户使用证明。
31. 申报EDA研发费用补贴的企业应从事集成电路自主安全可控EDA工具研发。
32. 交易主体应为非关联企业。
33. “IP”是指供应方提供的已形成知识产权并完成权属登记的，可直接用于二次开发的商品。“委托技术服务”是指委托方提出技术需求，由供应方研发，之后就该项技术形成知识产权，权属由双方自行约定。
34. **支持企业流片**
35. **支持方式**
36. 在东湖高新区外开展MPW流片，按照流片费用的10%，给予同一企业每年最高不超过100万元补贴。
37. 在东湖高新区开展MPW流片，按照流片费用的20%，给予同一企业每年最高不超过200万元补贴。
38. 在东湖高新区外开展首轮工程产品流片，按照流片费用的20%，给予同一企业每年最高不超过500万元补贴。
39. 在东湖高新区开展首轮工程产品流片，按照流片费用的30%，给予同一企业每年最高不超过1500万元补贴。
40. **申报条件**
41. 企业进行MPW（多项目晶圆）流片，“MPW流片”是指将多个具有相同工艺的集成电路设计放在同一晶圆上流片，按面积分摊流片费用，以降低开发成本和新产品开发风险。
42. 企业进行首轮工程产品流片，“首轮工程产品流片”是指集成电路企业将其研发的新型号芯片与芯片制造企业（或全资子公司）、代流片企业开展产品量产前的全掩膜板（Full Mask）流片，并就对应型号芯片首次签订流片合同，合同所载晶圆数量不得高于25片，产品已获得集成电路布图设计登记证书。流片费用包括：掩膜版制作费、晶圆购置费、制造端IP授权费、测试加工费。
43. **支持企业做大做强**
44. **支持方式**
45. 对上一年度营业收入首次突破2000万元、5000万元、1亿元、5亿元、10亿元的集成电路设计企业，分别给予50万元、100万元、200万元、500万元、1000万元一次性奖励；
46. 对上一年度营业收入首次突破10亿元、50亿元、100亿元的集成电路制造企业，分别给予300万元、500万元、1000万元一次性奖励；
47. 对上一年度营业收入首次突破1亿元、5亿元、10亿元的集成电路封装、测试、装备、材料等企业，分别给予100万元、200万元、400万元一次性奖励。
48. 上一年度营业收入数据以企业在东湖高新区入统数据及年度审计报告为准，数据不一致时取低值。以上奖补资金鼓励用于核心团队绩效奖励。
49. 对涉及多项集成电路业务的企业，根据年营业收入占比最高项业务确定其申报奖励的类别。
50. 申报首次突破奖励的企业应已完成“小进规”，未完成的企业在“小进规”后拨付奖励资金。年度营业收入首次突破2000万元的奖励资金与工业“小进规”、服务业“小进规”等区级奖励资金不可重复享受。
51. **申报条件**
52. 企业年度营业收入首次突破支持目标金额，其集成电路营业收入占比应超过50%，不足50%的按其集成电路实际营业收入核算。
53. 首次突破是指自企业成立之日起首次突破。
54. **支持补链项目建设**
55. **支持方式**
56. 集成电路设计项目固定资产投资1000万元以上的，按照实际投入的20%给予补贴；固定资产投资1亿元以上的，按照实际投入的22%给予补贴；补贴金额最高不超过1亿元。
57. 集成电路制造项目固定资产投资10亿元以上的，按照实际投入的10%给予补贴；固定资产投资30亿元以上的，按照实际投入的12%给予补贴；补贴金额最高不超过5亿元。
58. 集成电路封装、测试、设备、材料项目固定资产投资1亿元以上的，按照实际投入的10%给予补贴；固定资产投资10亿元以上的，按照实际投入的12%给予补贴；补贴金额最高不超过2亿元。
59. 项目固定资产投资规模以东湖高新区统计部门认定的数据及项目专项审计报告为准，数据不一致时取低值。
60. 对涉及多项集成电路业务的企业，根据年营业收入占比最高项业务确定其申报奖励的类别。
61. **申报条件**
62. 项目于支持周期内完工并实现销售。
63. 项目填补东湖高新区产业链空白。
64. **实施产业链供应链贯通工程**
65. **支持方式**

对在区内开展采购和销售活动，按照实际交易金额的10%给予奖励（采购方、销售方各给予5%），同一企业每年奖励金额最高不超过1000万元。

1. **申报条件**
2. 企业在区内开展集成电路产品采购或销售活动，采购方及销售方均为区内企业。
3. 交易的产品为销售方自主研发并已获得相应知识产权（包括专利权、集成电路布图设计登记证书等），且直接用于采购方后续研发或生产。采购方不应为成本（费用）中心。
4. 交易双方为非关联企业。
5. **支持举办行业交流培训赛事活动**
6. **支持方式**

按照实际费用的30%，给予单个活动最高50万元补贴，同一单位每年最高不超过200万元补贴。

1. **申报条件**
2. 支持周期内集成电路企业在区内开展集成电路领域高峰论坛、技术培训、创新大赛、行业沙龙等活动。活动应面向公众举办、具有广泛社会效应。
3. 活动举办前，活动方案、活动预算应报东湖高新区发展改革局备案。
4. 申报材料

企业按照申报类别要求分别准备申报材料，在申报系统完成申报后，按要求从系统导出申报信息及对应的附件材料，将导出的文件打印，汇编后装订成册并加盖企业公章，于申报时间内提交汇编材料壹份至东湖高新区发改局。

1. **支持人才集聚**
2. 附件2《申报书》
3. 附件3《承诺函》
4. 附件4《人才集聚申报表》
5. **支持企业集聚**
6. 附件2《申报书》
7. 附件3《承诺函》
8. 附件5《企业集聚申报表》
9. **支持购买设计工具**
10. 附件2《申报书》
11. 附件3《承诺函》
12. 附件6《购买设计工具申报表》
13. **支持企业流片**
14. 附件2《申报书》
15. 附件3《承诺函》
16. 附件7《企业流片申报表》
17. **支持企业做大做强**
18. 附件2《申报书》
19. 附件3《承诺函》
20. 附件8《企业做大做强申报表》
21. **支持补链项目建设**
22. 附件2《申报书》
23. 附件3《承诺函》
24. 附件9《补链项目建设申报表》
25. **实施产业链供应链贯通工程**
26. 附件2《申报书》
27. 附件3《承诺函》
28. 附件10《供应链贯通工程申报表》
29. **支持举办行业交流培训赛事活动**
30. 附件2《申报书》
31. 附件3《承诺函》
32. 附件11《举办行业交流培训赛事活动申报表》